

非破壊によるメッキの膜厚測定ならお任せください

メッキの膜厚解析

詳細はこちら www.oeg.co.jp/env_meas/plating.html

概要 断面観察可能な試料を作成後、電子顕微鏡による像を撮影し、その像から層ごとの距離を直接計測する場合、非破壊ではないためサンプルを加工する必要があります。
OKIエンジニアリングでは、蛍光X分析装置（XRF）を使用した元素比から対象元素の層ごとの膜厚を非破壊による解析が可能です。

特長

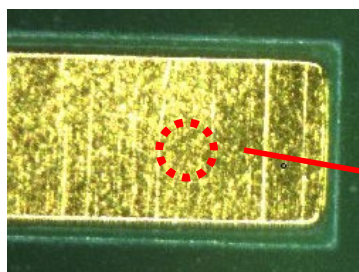
- ・非破壊による多層メッキの膜厚を算出します。
- ・Au/Ni/Cuなど多層のめっきを層ごとに算出が可能です。
- ・最小の測定範囲は、17 μ mとなり微小域でも対応可能です。
- ・断面観察可能な試料を作成～電子顕微鏡による像を撮影、層ごとの距離を直接計測も対応可能

蛍光X線分析例

非破壊による多層メッキの膜厚を算出可能です。測定スポット径は、20 μ m、170 μ m、1mmから選択可能です。

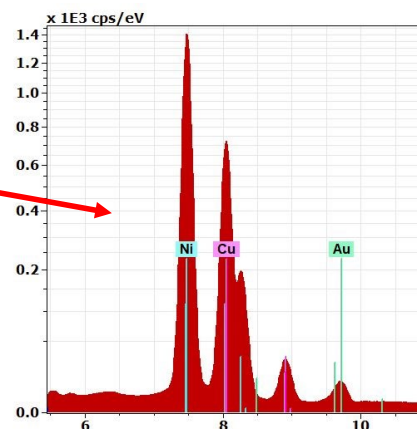


測定装置



測定点を画像から選択し
測定結果から算出

C u	N i	A u
21 μ m	5.5 μ m	0.05 μ m



EPMA分析例

試料の断面観察を行い、電子顕微鏡にて層の直接計測をおこなえば、断層の状況も確認が可能です。

